



中美矽晶製品股份有限公司
Sino-American Silicon Products Inc.

A large graphic on the left side of the slide. It features a central dark green circle with the white text "SAS". This circle is surrounded by a network of white dots connected by thin white lines, forming a complex web. The entire graphic is set against a background of concentric, semi-transparent circles in shades of green and yellow, with some segments appearing as if they are missing or broken. The overall effect is a sense of dynamic growth and interconnectedness.

SAS

中美矽晶 (5483 TT) 2024年Q2營運報告

2024年8月



Disclaimer

This presentation has been prepared by Sino-American Silicon Products Inc. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.



- 01 經營團隊重點報告
- 02 公司簡介
- 03 產業概況
- 04 中美矽晶合併營運報告
- 05 ESG亮點
- 06 環球晶圓



01

經營團隊重點報告



經營團隊重點報告

1. 財務表現

■ 營業收入

- ✓ 2024年第二季 → 新台幣 199 億元，季增1.0%，歷年同期第三高！
- ✓ 2024年上半年 → 新台幣 396 億元，年減4.0%，歷年同期次高！

■ 營業毛利率

- ✓ 2024年第二季 → 32.0%
- ✓ 2024年上半年 → 31.7%

■ 營業淨利率

- ✓ 2024年第二季 → 21.8%
- ✓ 2024年上半年 → 22.0%



經營團隊重點報告

1. 財務表現 (續)

■ 稅後淨利率

- ✓ 2024年第二季 → 17.8%
- ✓ 2024年上半年 → 18.9%

■ 每股盈餘

- ✓ 2024年第二季 → 新台幣 2.94 元
- ✓ 2024年上半年 → 新台幣 6.35 元

經營團隊重點報告

2. 再生能源產業展望

■ 全球

- ✓ 彭博新能源財經《新能源展望報告2024》指出，為達成2050年淨零碳排目標，全球需新增35兆瓦再生能源裝置容量
- ✓ 根據國際能源署（IEA）最新發布的《世界能源投資報告》，2024年全球能源投資總額將首次突破3兆美元，其中高達2兆美元將用於再生能源技術和基礎設施的開發

■ 台灣

- ✓ 台灣於2016年宣佈能源轉型政策，目標在2050年前實踐淨零碳排，其中再生能源佔比達60-70%
- ✓ 截至2024年6月，台灣的再生能源裝置容量已達19.6GW，其中太陽能光電佔比近70%，約為13.4GW
- ✓ 為了達到2030年太陽能裝置容量30GW的目標，平均每年需建置3GW的太陽能發電裝置

經營團隊重點報告

3. 營運策略

- 中美矽晶為企業集團，版圖橫跨半導體、汽車元件及再生能源，憑藉過去數十年積極的投資策略和發掘優質潛力公司之能力，已成功建立平衡且多元的投資組合
 - ✓ 半導體 / 汽車元件：
 - 透過與上下游結盟，中美矽晶建構具競爭力的產業鏈佈局，藉由其國際級的資源和半導體網絡持續推動集團成長
 - ✓ 再生能源
 - SAS高度重視永續獲利能力，並已成功由傳統製造商轉型為再生能源全方位解決方案提供者
- 中美矽晶與重要集團公司深度合作實現綜效，擴大彼此經營版圖，帶領集團企業共同繁榮

重要集團公司	2024年上半年營業收入 (百萬新台幣)	年增率	基本每股盈餘	年增率
朋程科技 ¹	3,684	+53%	NT\$4.35	- NT\$0.59
宏捷科技 ²	2,593	+199%	NT\$2.15	+ NT\$3.14
台特化 ³	405	+96%	NT\$1.13	+ NT\$0.89

備註：1. 包含朋程科技股份有限公司；2. 宏捷科技股份有限公司；3. 台灣特品化學股份有限公司

經營團隊重點報告

4. 環球晶圓

■ 營業收入

- ✓ 2024年第二季 → 新台幣 153 億元，季增1.6%，歷年同期第三高！
- ✓ 2024年上半年 → 新台幣 304 億元，年減16.7%，歷年同期第三高！

■ 營業毛利率

- ✓ 2024年第二季 → 32.3%
- ✓ 2024年上半年 → 33.3%

■ 營業淨利率

- ✓ 2024年第二季 → 22.0%
- ✓ 2024年上半年 → 24.1%



經營團隊重點報告

4. 環球晶圓（續）

■ 稅後淨利率

- ✓ 2024年第二季 → 18.8%
- ✓ 2024年上半年 → 21.1%

■ 每股盈餘

- ✓ 2024年第二季 → 新台幣6.02元
- ✓ 2024年上半年 → 新台幣14.04元

■ 預收貨款

- ✓ 新台幣 349億元 (美金11億元)¹

經營團隊重點報告

5. 半導體產業展望

■ 全球經濟

- ✓ 2024年全球經濟成長率可望持穩，並於2025年溫和增長。即使面對通貨膨脹，經濟成長仍展現韌性，有望在疫情後「軟著陸」，惟不可忽視貿易緊張局勢，以及地緣政治衝突之風險

■ 半導體產業

- ✓ 2.5D與3D先進封裝技術的革新，顯著提升了晶片性能，尤其是高頻寬記憶體(HBM)晶片的效能，推動了晶圓需求的成長
- ✓ 人工智慧電子設備的普及，以及AI換機潮的興起，預期將推升周邊IC及各種感測器的需求，為其帶來成長動能
- ✓ 隨著2025年半導體庫存逐漸去化，加上下游客戶擴大產能。半導體產業有望於2024下半年復甦，並對2025年前景保持樂觀

6. ESG

■ 公司治理評鑑

- ✓ 2023年第十屆公司治理評鑑中，中美矽晶和環球晶圓分別連續十年和六年榮獲上櫃公司治理評鑑前百分之五
- ✓ 2023年中美矽晶再度入選《CommonWealth Magazine》百強企業
 - 在72家半導體公司中營業收入排名第6
 - 在1,350家製造業公司中稅後淨利排名第24
- ✓ SAS高度重視公司治理，董事會超過三分之一為獨立董事，並實施嚴謹年度評估機制，以確保公司在治理、資訊透明及經營責任等方面均能符合最高標準



02

公司簡介

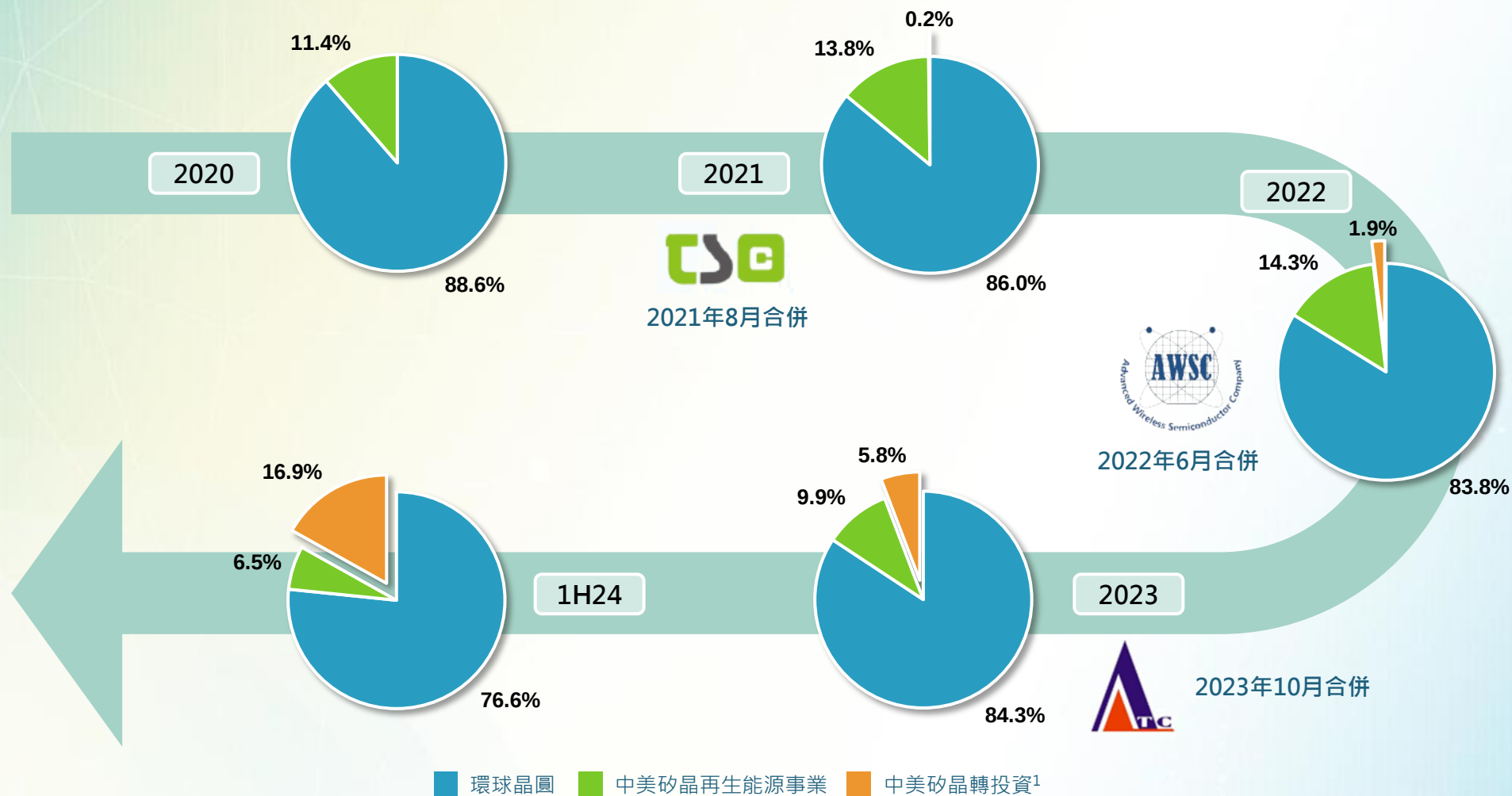
中美矽晶 – 提升集團綜效的策略推動者

- 善用中美矽晶的關鍵資源，如全球網絡、銷售通路、管理專長等，落實集團公司間的互惠綜效
- 賦能各集團公司提升策略視野及強化其成長動能
- 廣納更多具發展潛力的企業以擴大生態系



依事業別之集團營收

- 發展更平衡且多元的集團事業組合
- 建立於環球晶圓的穩固基礎上，中美矽晶之轉投資已成為集團持續成長的催化劑



備註：總營收為環球晶圓、中美矽晶再生能源事業、及其他轉投資公司。2024上半年數據是根據公開資訊觀測站所公佈之月營收；1. 包含朋程、宏捷科、台特化

中美矽晶 – 具代表性的企業集團

- 透過與策略性夥伴的合作，中美矽晶已在半導體產業建立起強勁的競爭地位，我們的全球產能、綿密的銷售網絡和多元的產品組合（矽、化合物半導體、特殊氣體及化學濾網等）持續推動集團成長



中美矽晶之產品應用深入日常生活及未來科技



中美矽晶 – 具代表性的企業集團

- 除半導體及相關應用材料外，中美矽晶也跨足再生能源、風電、水電和太陽能等綠電銷售，供應給具有綠電需求的半導體客戶或中美矽晶集團成員



中美矽晶於再生能源的投入符合全球更乾淨、更永續的發展趨勢

aleo Aleo Solar GmbH

SPW 旭鑫分公司

SAS Sunrise Sulu Electric Power and Light Phils.

Silfab SOLAR

nextDrive 聯齊科技

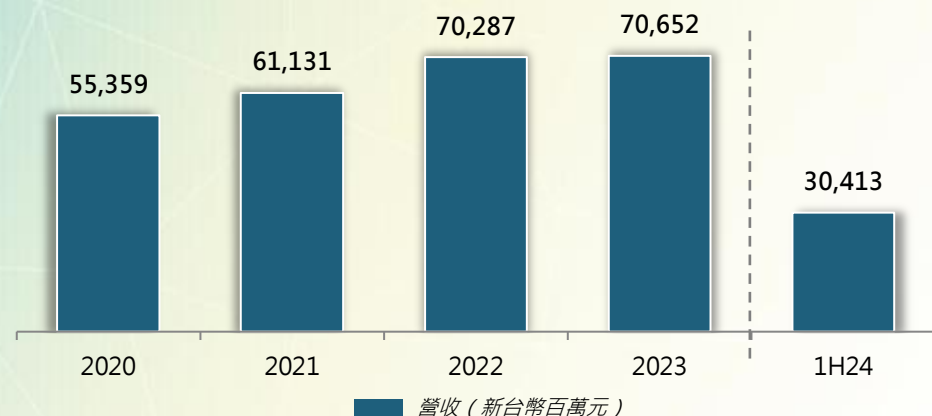
BILLION GLOBAL 盛達電業

SES 續興

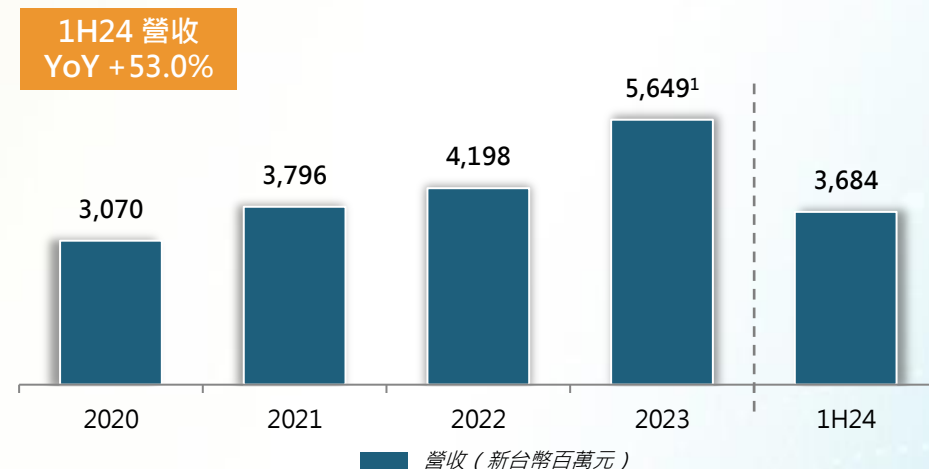
重要集團公司的近期表現

- 中美矽晶集團公司：朋程、台特化及宏捷科於2024上半年皆繳出亮眼成績單

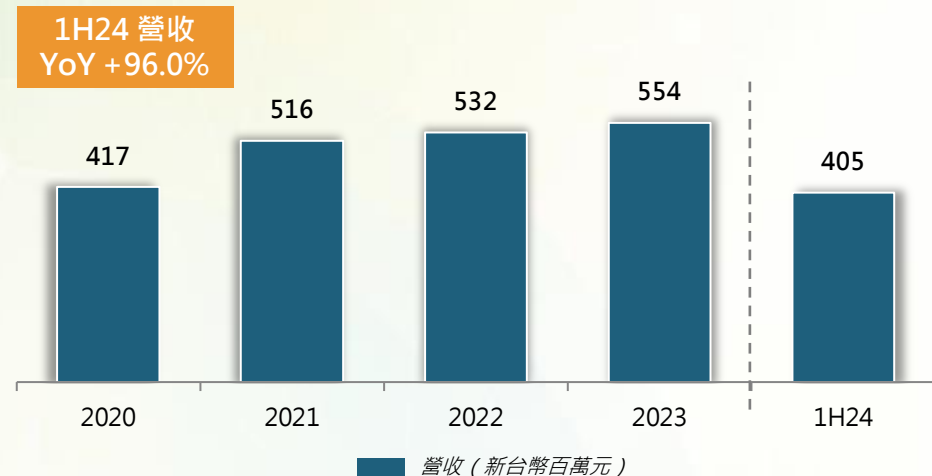
環球晶圓



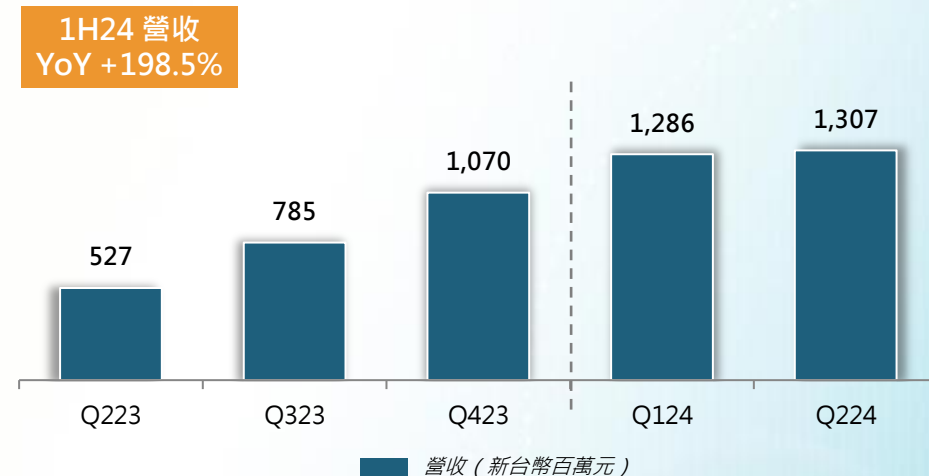
朋程



台特化



宏捷科



備註：1. 茂矽於2023年六月合併至朋程



03

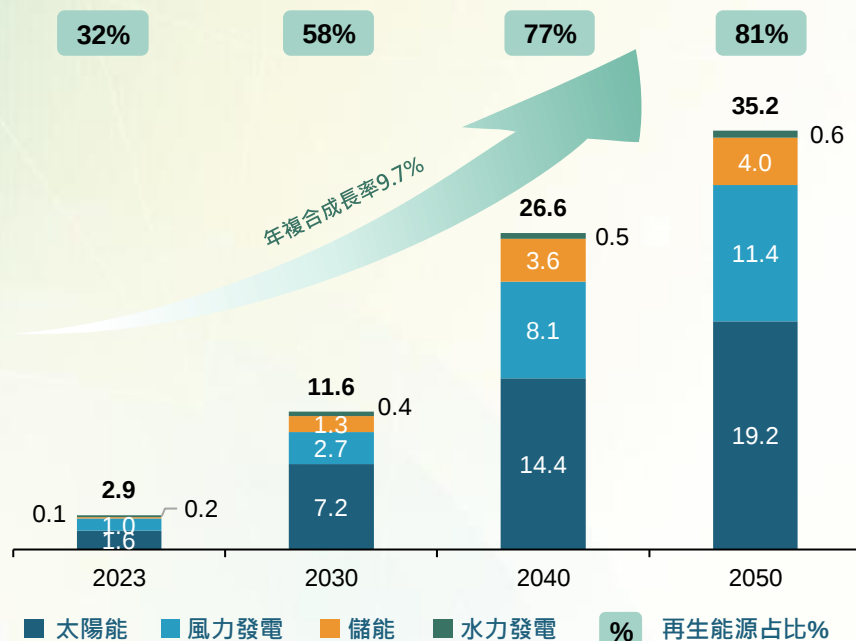
產業概況

全球能源投資趨勢

- 依據彭博新能源財經最新的《新能源展望報告2024》，若要符合2050年淨零碳排的目標，則需再建置35兆瓦的再生能源裝置容量，占總能源容量比例達81%
- 全球能源投資金額將在2024年首次超過3兆美元，其中有2兆美元將投入到再生能源技術和基礎設施，包括再生能源、電網和儲能、能效和終端應用、核能和其他再生能源¹以及低碳燃料²

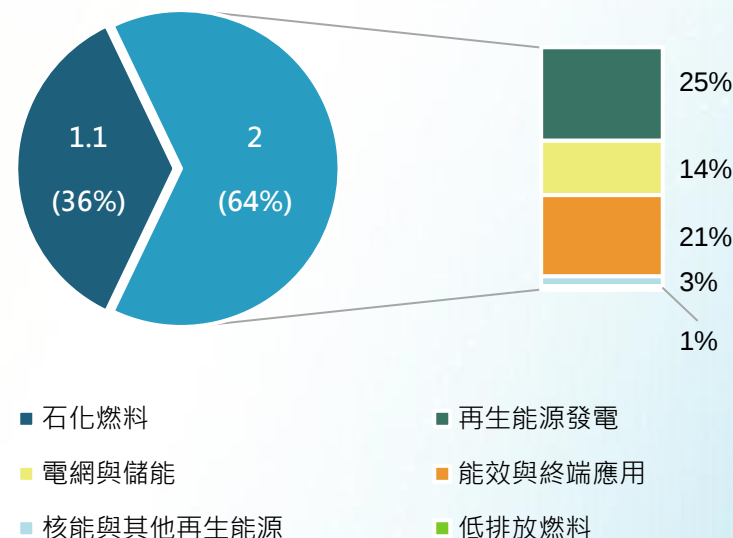
2050淨零碳排情境下的全球再生能源裝置容量

(TWh)



2024年全球再生能源與化石燃料投資

(兆美元)



資料來源：彭博新能源財經《新能源展望報告2024》，國際能源署《世界能源投資》，2024年5月

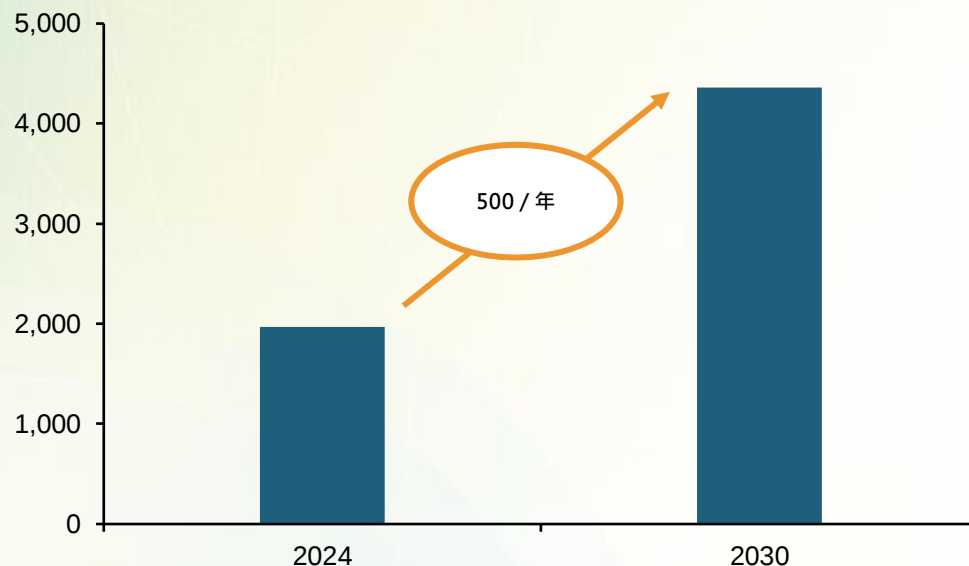
備註：1. 其他清潔能源包括基於碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）的化石燃料、氫能、氨能和大型熱泵。2. 低碳燃料包括現代生物能源、低排放氫氣燃料、與CCUS和直接空氣捕獲技術相關的化石燃料

2030年前投資額翻倍是實現COP28目標的關鍵

- 若將2030年再生資源總裝置容量提升至現今的三倍以上，延續當前投資趨勢只能落實所需投資的三分之二。若要達到國際能源署2050淨零碳排的目標，每年需增加5,000億美元投資，才能彌補資金缺口
- 要實現COP28目標，2030年前全球再生能源¹投資額需翻倍，而除中國外的新興市場和發展中國家投資額需增至四倍

2030年再生能源總裝置容量提升至現今三倍所需的額外投資額

(十億美元)

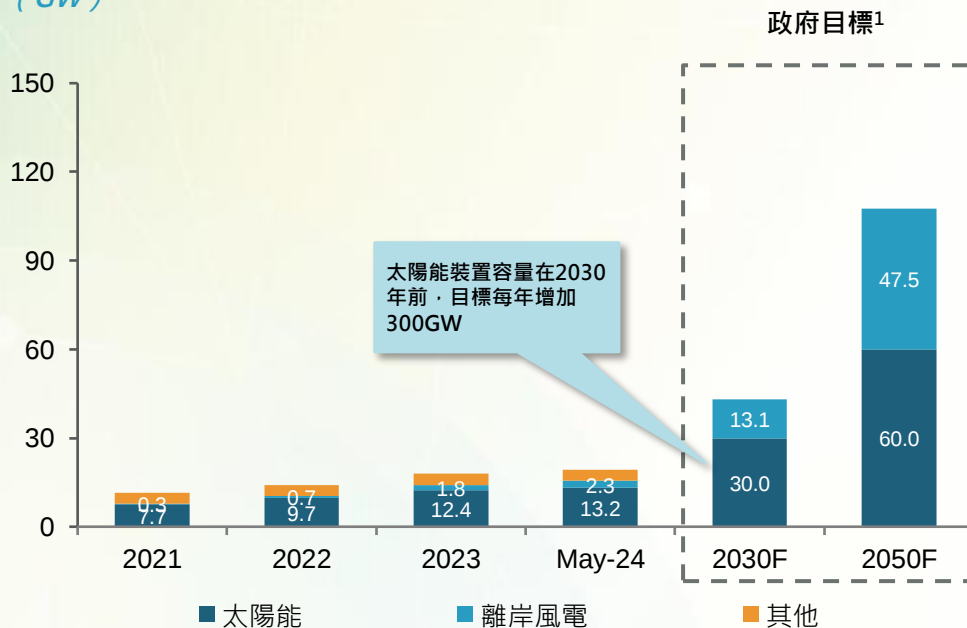


台灣再生能源發展的野心

- 台灣能源轉型政策以2025年實現非核家園與再生能源發電量佔15.5%為目標，並宣佈2050年前要達到淨零碳排，再生能源佔比須提升到60~70%；截至2023年底，再生能源總發電量佔比為9.5%
- 截至2024年六月，再生能源裝置容量累積達19.6GW，太陽能光電佔比近70%（13.4GW），若以2030年之30GW目標計算，每年平均安裝量須達近3GW
- 企業再生能源需求因ESG、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、RE100、及用電大戶條款等上升，進而擴大再生能源交易市場機會

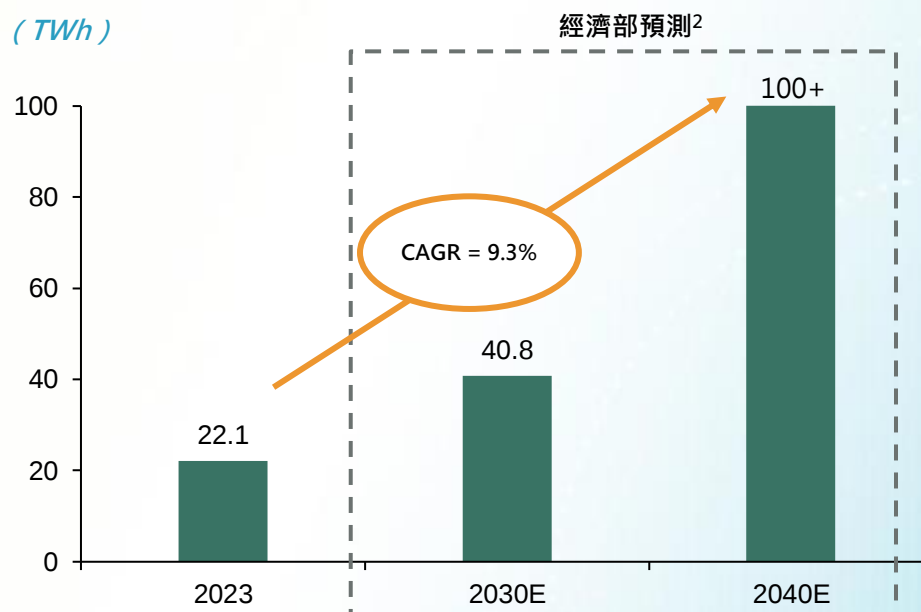
台灣再生能源裝置容量（2021~2050）

(GW)



台灣企業綠電需求

(TWh)



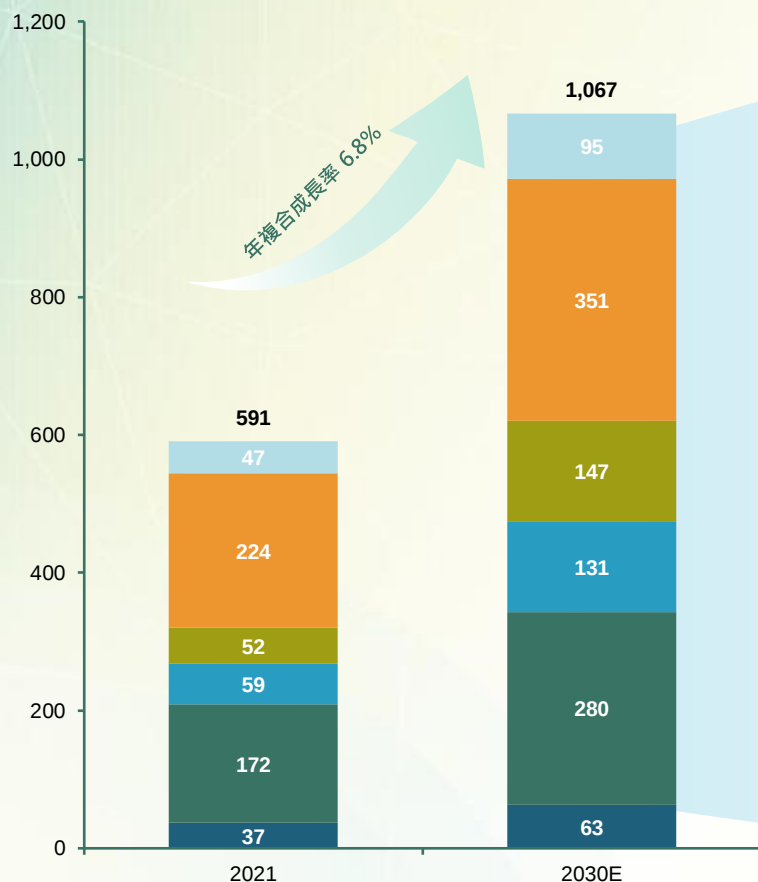
資料來源：綠能科技產業推動中心、經濟部、國家發展委員會

備註：1. 2030年及2050年預估數字取自政府目標之中間值。2. 經濟部預估企業綠電需求將超過1,000億度

全球半導體市場持續成長

- 預期全球半導體市場將迅速成長並在2030年時達到1兆美元

(十億美元)



消費性電子



~10%

新產品及可穿戴裝置的滲透帶動需求

運算及資料儲存



~27%

AI及雲端運算帶動伺服器需求提升

汽車元件



~20%

自動駕駛及智慧移動帶動需求成長

工業電子



~15%

半導體用於智慧、集中和最佳化的製造需求增加

無線通訊



~23%

需求的攀升主要來自於5G的演進、網路雲端畫、AI與手機使用的增加

有線通訊



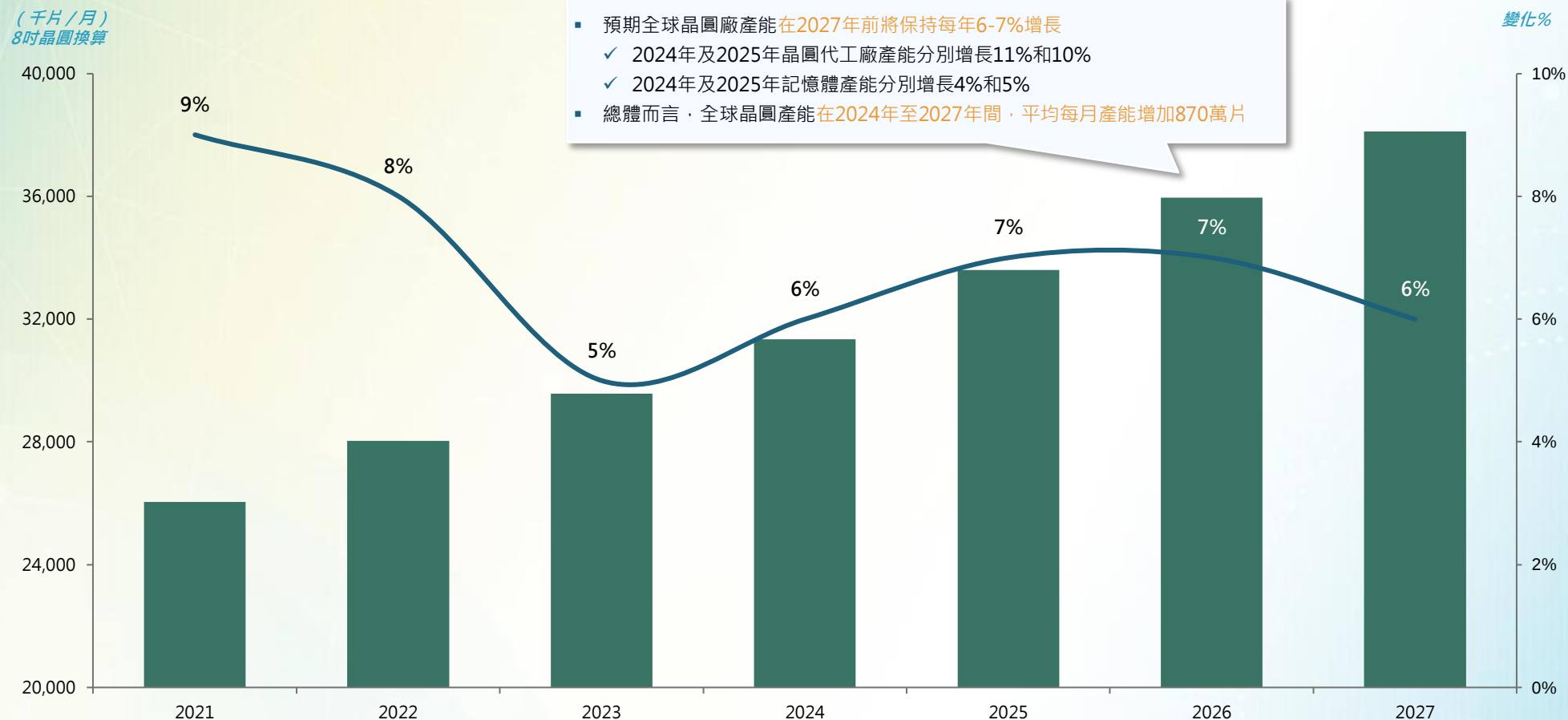
~5%

開發中國家寬頻滲透率提高刺激需求

全球半導體晶圓廠擴產

■ AI的普及驅動高效能晶片的研發，並帶動全球半導體晶圓廠產能強勁擴張

全球半導體晶圓廠產能預估





04

中美矽晶合併營運報告

財務摘要：2024年第二季 vs. 2024年第一季 vs. 2023年第二季

(新台幣百萬元，除每股盈餘)	2024年第二季	2024年第一季	2023年第二季	季成長	年成長
營業收入	19,896	19,692	20,318	1.0%	-2.1%
營業毛利%	32.0%	31.5%	34.3%	0.5p.p.	-2.3p.p.
營業淨利	4,338	4,355	5,089	-0.4%	-14.7%
營業淨利%	21.8%	22.1%	25.0%	-0.3p.p.	-3.2p.p.
本期淨利	3,540	3,957	4,728	-10.5%	-25.1%
本期淨利%	17.8%	20.1%	23.3%	-2.3p.p.	-5.5p.p.
每股盈餘*1	NT\$2.94	NT\$3.40	NT\$4.15	-NT\$0.46	-NT\$1.21
EBITDA*2	6,152	6,903	8,114	-10.9%	-24.2%
EBITDA%	30.9%	35.1%	39.9%	-4.2p.p.	-9.0p.p.
EBIT*3	3,681	4,566	6,026	-19.4%	-38.9%
股東權益報酬率 / ROE*4 (按年度計算)	14.6%	18.7%	26.4%	-4.1p.p.	-11.8p.p.
資產報酬率 / ROA*5 (按年度計算)	5.8%	7.2%	9.7%	-1.4p.p.	-3.9p.p.

備註：

- 每股盈餘= 歸屬於本公司普通股權益持有人之淨利/ 普通股加權平均流通在外股數。
- EBITDA = 本期淨利+ 折舊費用+ 攤銷費用+ 淨利息+ 所得稅。
- EBIT = 本期淨利+ 淨利息+ 所得稅。
- ROE = 本期淨利/ 股東平均權益。
- ROA = ((本期淨利+ 利息費用* (1 - 有效稅率)) / 平均資產)。



財務摘要：2024年上半年 vs. 2023年上半年

(新台幣百萬元，除每股盈餘)	2024年上半年	2023年上半年	年成長
營業收入	39,589	41,222	-4.0%
營業毛利%	31.7%	35.3%	-3.6p.p.
營業淨利	8,694	10,887	-20.1%
營業淨利%	22.0%	26.4%	-4.4p.p.
本期淨利	7,497	9,442	-20.6%
本期淨利%	18.9%	22.9%	-4.0p.p.
每股盈餘*1	NT\$6.35	NT\$8.36	-NT\$2.01
EBITDA*2	13,055	16,205	-19.4%
EBITDA%	33.0%	39.3%	-6.3p.p.
EBIT*3	8,247	12,067	-31.7%
股東權益報酬率 / ROE*4 (按年度計算)	15.9%	27.1%	-11.2p.p.
資產報酬率 / ROA*5 (按年度計算)	7.4%	9.8%	-2.4p.p.

備註：

- 每股盈餘 = 歸屬於本公司普通股權益持有人之淨利 / 普通股加權平均流通在外股數。
- EBITDA = 本期淨利 + 折舊費用 + 攤銷費用 + 淨利息 + 所得稅。
- EBIT = 本期淨利 + 淨利息 + 所得稅。
- ROE = 本期淨利 / 股東平均權益。
- ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產)。

營業收入

(新台幣百萬元)



備註：

1. 2016年環球晶圓完成SunEdison半導體 (SEMI) 的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日
2. 調整後營收不包含資安事件影響

營業毛利

(新台幣百萬元)



備註：

- 2016年環球晶圓完成SunEdison半導體 (SEMI) 的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日
- 調整後毛利及調整後毛利率不包含資安事件影響

營業淨利

(新台幣百萬元)



備註：

1. 2016年環球晶圓完成SunEdison半導體 (SEMI) 的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日

稅後淨利



備註：

1. 2016年環球晶圓完成SunEdison半導體 (SEMI) 的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日

每股盈餘 (新台幣元)



備註：

1. 2016年環球晶圓完成SunEdison半導體 (SEMI) 的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日
2. 調整後EPS不包含資案事件影響

損益表

損益表					
(新台幣百萬元)	2022	2023	Q124	Q224	1H24
營業收入	81,871	81,966	19,692	19,896	39,589
成長率 (%)	18.9%	0.1%	-6.9% ²	1.0% ²	(4.0%) ²
營業毛利	31,929	26,687	6,195	6,358	12,553
營業毛利率 (%)	39.0%	32.6%	31.5%	32.0% ³	31.7%
EBITDA	27,486	30,598	6,903	6,152	13,055
EBITDA 率 (%)	33.6%	37.3%	35.1%	30.9%	33.0%
營業淨利	25,400	18,607	4,355	4,338	8,694
營業淨利率 (%)	31.0%	22.7%	22.1%	21.8% ⁴	22.0%
稅前淨利 ¹	20,829	24,549	5,066	4,571	9,637
稅前淨利率 (%)	25.4%	30.0%	25.7%	23.0% ⁵	24.3%
稅後淨利 ¹	16,160	17,779	3,957	3,540	7,497
稅後淨利率 (%)	19.7%	21.7%	20.1%	17.8% ⁶	18.9%
每股盈餘 (新台幣元) ¹	14.87	16.99	3.40	2.94	6.35

備註：

1. 受Siltronic按公允價值計量且其變動計入損益以及其他因素的影響
2. 第一季及第二季為季對季成長；上半年為年對年成長
3. 第二季毛利下降：主要由於環球晶圓折舊及存貨跌價損失調整之影響
4. 第二季營業利益下降：主要由於環球晶圓成本增加之影響
5. 第二季稅前淨利下降：主要由於所得稅費用回轉之影響
6. 第二季淨利下降：主要由於世創股票評價損失之影響

資產負債表

資產負債表				
(新台幣百萬元)	2022	2023	Q124	Q224
資產				
現金及約當現金	83,248	30,828	40,925	50,360 ¹
應收帳款	11,338	12,228	12,403	12,520
存貨	10,790	12,556	13,768	13,945
不動產、廠房、設備	51,866	89,668	99,432	111,440 ²
其他資產	39,368	80,216	73,544	84,957
資產總計	196,609	225,495	240,071	273,221
負債				
短期借款	9,831	47,427	44,295	51,787 ³
應負帳款	5,130	5,959	5,311	5,249
長期借款	43,648	17,169	32,092	32,864
其他負債	69,868	72,946	70,709	76,472
負債總計	128,478	143,501	152,407	166,373
權益總計	68,132	81,994	87,664	106,848⁴

現金資產細項包含以下子公司
環球晶圓的項目：

(新台幣百萬元)	Q224
三個月以上定存	25,223
受限制現金	16,347
*受限制現金因稅賦考量，暫時存入受限制帳戶但可隨時動用	

備註：

- 現金及約當現金增加：主要由於環球晶圓發行 GDR 所致。(GDR 指全球存託憑證)
- 財產、廠房及設備增加：主要由於中美矽晶針對 Topcon 太陽能模組的資本支出。
- 短期借款增加：主要由於 GlobalWafers America, LLC 的資本支出。
- 股東權益增加：主要歸因於環球晶圓募資所致的非控制性權益增加。



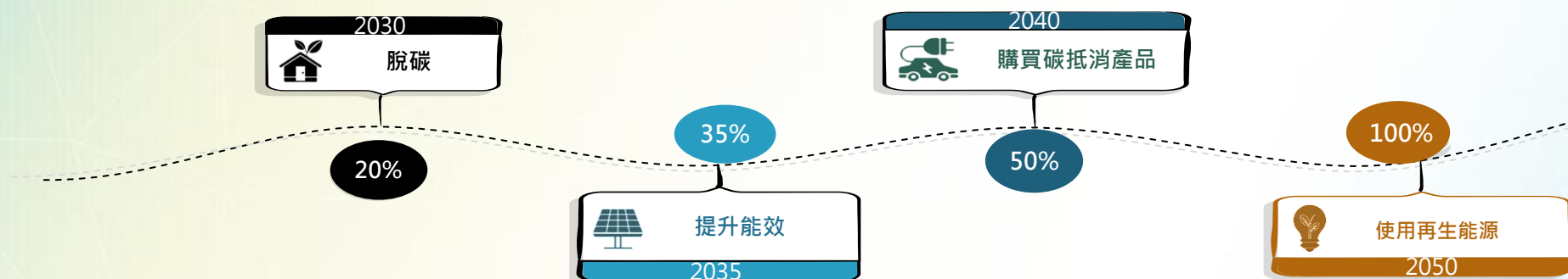
05

ESG亮點

環境環保方面：致力於發展綠色能源

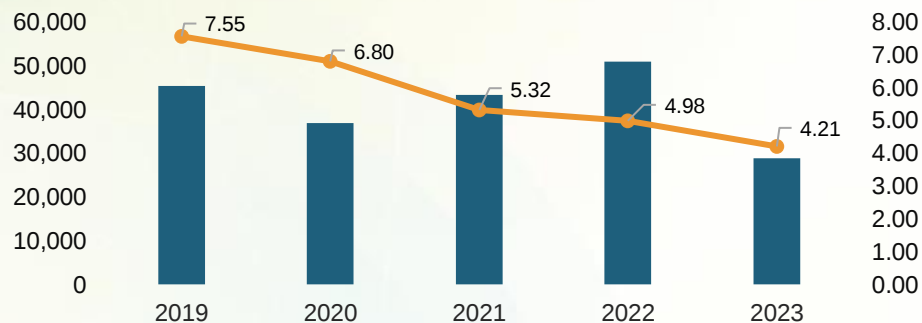
- 為以實際行動支持台灣實踐淨零碳排，中美矽晶承諾至2050年全球所有運營基地100%使用再生能源
- 從2021年到2023年，中美矽晶及關聯企業有效降低水、電之消耗，盡可能減少環境影響，穩步實踐ESG目標

漸進目標與氣候藍圖



碳排強度 (碳排放量/收入)

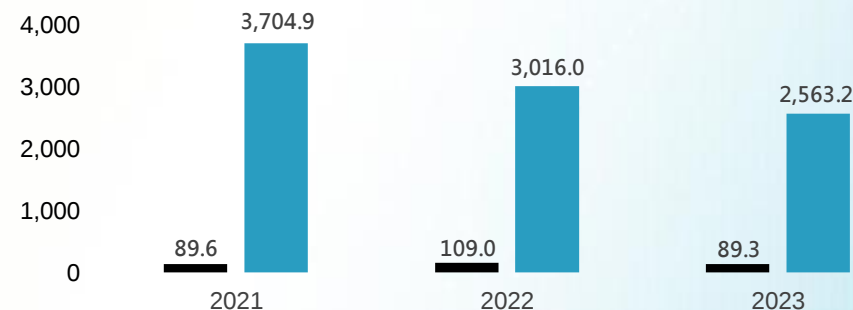
(噸二氧化碳當量/年)



■ 噸二氧化碳當量/年 — 噸二氧化碳當量/百萬新台幣收入

總用水量

(10⁴ 升)



■ 中美矽晶 ■ 關聯企業

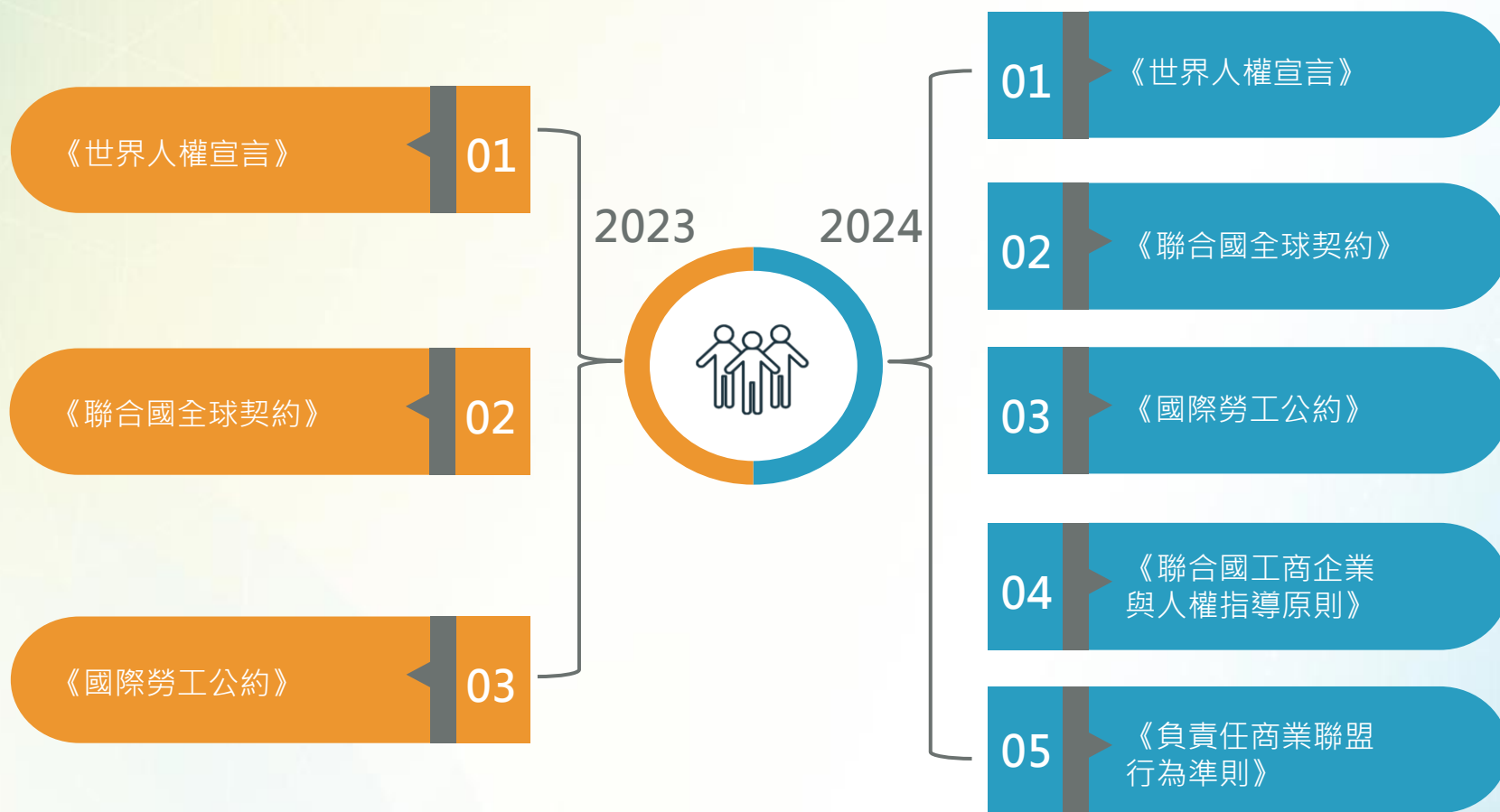
環境環保方面：地球關燈一小時

- 中美矽晶與關聯企業朋程科技¹、宏捷科技²和台特化³於2024年首次參加世界關燈日“地球一小時”活動，實踐對淨零碳排和聯合國可持續發展目標的堅定承諾，中美矽晶將 ESG 融入企業使命，激發集團協同效應，共創永續未來



社會責任方面：人權保護

- 中美矽晶嚴格執行國際公約和相關之人權規定，於2024年引入《聯合國工商企業與人權指導原則》和《負責任商業聯盟行為準則》
- 中美矽晶重視員工福祉、尊重多樣性、培養自主性，並致力於創造積極向上的工作環境



公司治理方面：台灣業界領袖

- 中美矽晶致力於踐行公司治理和社會責任，**連續十年**躋身台灣上櫃公司前5%
- 2023年公司再度入選《天下雜誌》百強企業。在半導體業**營業收入排名第6**，在台灣1,350家製造業企業**稅後淨利排名第24**

- 在半導體業**營業收入排名第6**
- 在台灣1,350家製造業企業**稅後淨利排名第24**



過去10年公司治理評鑑
排名上櫃公司前5%

每年評估董事和會計師的獨立性和表現，並在公司官網上公佈評估結果

設立審計、薪酬、提名和可持續發展委員會，以強化獨立性和企業社會責任



06

環球晶圓

損益表					
(新台幣百萬元)	2022	2023	Q124	Q224	1H24
營業收入	70,287	70,652	15,087	15,326	30,413
成長率 (%)	15.0%	0.5%	-10.0%	1.6%	-16.7%
營業毛利	30,342	26,441	5,168	4,951 ²	10,119 ²
營業毛利率 (%)	43.2%	37.4%	34.3%	32.3% ²	33.3% ²
EBITDA	25,526 ¹	30,630	5,882	4,600	10,482
EBITDA 率 (%)	36.3%	43.4%	39.0%	30.0%	34.5%
營業淨利	24,983	20,059	3,968	3,367	7,334
營業淨利率 (%)	35.5%	28.4%	26.3%	22.0%	24.1%
稅前淨利	20,107 ¹	26,496	4,558	3,531	8,089
稅前淨利率 (%)	28.6%	37.5%	30.2%	23.0%	26.6%
稅後淨利	15,367 ¹	19,770	3,533	2,879	6,412
稅後淨利率 (%)	21.9%	28.0%	23.4%	18.8%	21.1%
每股盈餘 (新台幣元)	35.31 ¹	45.41	8.10	6.02	14.04 ³

備註：

1. 認列其持有之Siltronic股票評價和其他因非營運之因素等影響
2. Q224毛利降低：主因折舊、資安事件電力成本增加及等因素所致
3. 由於增資關係，股數採用加權平均計算，因此每股盈餘並非恆等式

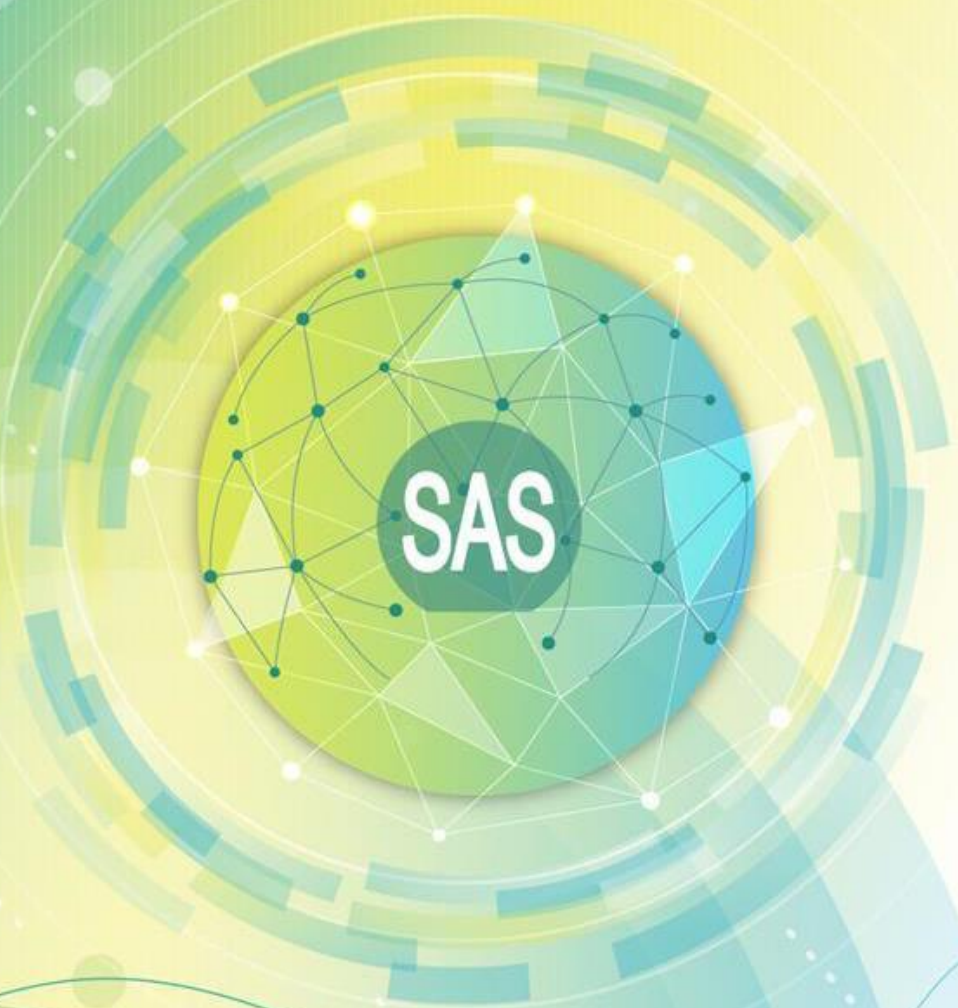
資產負債表

資產負債表					現金資產細項包含：	
(新台幣百萬元)	2022	2023	Q124	Q224	(新台幣百萬元)	Q224
資產					三個月以上定存	25,223
現金及約當現金	80,491	26,165	35,672	44,178 ¹	受限制現金	16,347
應收帳款	10,160	10,116	10,061	9,783	*受限制現金因稅賦考量，暫時存入受限制帳戶，但可隨時動用	
存貨	8,535	9,359	10,737	11,056		
不動產、廠房、設備	39,487	72,251	82,399	94,434		
其他資產	30,823	71,097	63,914	75,373		
資產總計	169,496	188,988	202,783	234,825		
負債						
短期借款	6,544	40,000	36,630	45,786 ²		
應負帳款	4,176	5,027	5,189	4,049		
長期借款	42,780	14,542	29,007	28,664		
其他負債	61,672	62,966	60,436	65,537 ³		
負債總計	115,172	122,534	131,262	144,036		
股東權益	54,324	66,454	71,521	90,789 ⁴		

備註：

1. Q224現金及約當現金增加：主要係發行海外存託憑證
2. Q224短期借款增加：主要係因新廠和舊廠擴建所致
3. Q224其他負債增加：主要係因股利發放
4. Q224股東權益增加：主要係因現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，資本公積增加所致

Q&A



SAS

Thank You



Learn More on
Our Website